

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-308222

(43)Date of publication of application : 02.11.2001

(51)Int.Cl.

H01L 23/12
H01L 21/60
H05K 1/02
H05K 1/18
H05K 3/34
// H01L 25/065
H01L 25/07
H01L 25/18

(21)Application number : 2000-128285

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 21.04.2000

(72)Inventor : KOMIYA YASUMARO
SUGA TAKU
HAYASHI YOSHIIKO

(54) MOUNTING BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a feeding structure of power source of low cost and low impedance aiming to reduce power source noise which causes malfunction of a high speed logic circuit.

SOLUTION: An insulating layer of a power source layer which connects a LSI and a by-pass capacitor is made thin, so as to reduce impedance of the power source layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

BEST AVAILABLE COPY

<http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAAvpay.SDA413308222P...> 2005/06/23

(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-308222

(P2001-308222A)

(43) 公開日 平成13年11月2日 (2001.11.2)

(51) Int. Cl.	識別記号	P I	チーフド (参考)
H 0 1 L 23/12		H 0 1 L 21/00	3 1 1 S 5 E 3 1 9
21/60	8 1 1	H 0 5 K 1/02	N 5 E 3 3 6
H 0 5 K 1/02		1/18	L 5 E 3 8 8
1/18			S 5 P 0 4 4
		3/34	5 0 5 A

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全9頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-128285(P2000-128285)

(22) 出願日 平成12年4月21日 (2000.4.21)

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72) 発明者 小宮 泰康

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

(72) 発明者 須賀 卓

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

(74) 代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

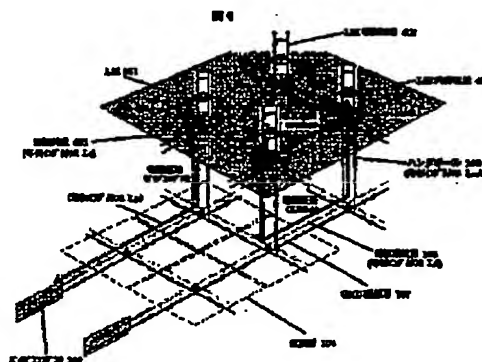
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 実装基板

(57) 【要約】

【課題】 高速論理回路の誤動作要因となる電源雑音の抑制を目的として低コストな低インピーダンス電源給電構造を提供する。

【解決手段】 L S I とバイパスコンデンサを接続する電源層に対して、絶縁層を薄膜化し、電源層のインピーダンスを低減する。



[illegible]

222803-100200

[illegible]

222806-1002附註

(4)

特開2001-308222

5

6

て1/10にすることができた。この結果、隣接するLSIの内部容量403間の電源経路（基板経由）を40～50pHの低インダクタンスにて接続することができ、 $L_c=200\sim300\text{pH}$ を有する電源幹線401に対し1/5～1/8のインダクタンス値に低減された電源経路を構成することができた。

【0024】また絶縁層106の薄膜化による電源層インダクタンスの低減は、LSI101とバイパスコンデンサ102との間のインダクタンス L_p を低減することにもなり、高周波領域における給電構造の電源-GND間のインピーダンスを低減した電源層104を実現することができた。

【0025】例えば、絶縁層106の膜厚が100 μm の電源層を用いた基板に比べて、膜厚が3 μm の電源層を用いた基板では、LSI-バイパスコンデンサ間のインダクタンス L_p を1/10以下にすることができた。

【0026】図7は本発明の給電構造の電気的等価回路における電源インピーダンス周波数特性の解析結果である。10M～1GHzの周波数領域において、絶縁層106の膜厚が100 μm の電源層104では電源インピーダンス Z は最大値で15.5m Ω を示しているが、絶縁層106の膜厚が5 μm で構成された電源層104では、 $Z=5.8\text{m}\Omega$ と約1/3に低減することが可能となった。

【0027】図8は、実装基板上に薄膜形成された薄膜電源層801を新たに構成することで、電源経路（基板経由）および電源経路（バイパスコンデンサ）のインダクタンスを低減し、給電構造のインピーダンスを低減したものである。

【0028】本構造は従来のLSIモジュールに対して、薄膜電源層を形成する工程を追加するだけで実現することが出来、同様に電源インピーダンスを低減することが出来る。

【0029】例えば、絶縁層106の膜厚が100 μm の電源層104に対して、絶縁層厚3 μm 程度の薄膜電源層801を新たに構成すると、電源層の電源パンプ間インダクタンスを70pHから2pHと大幅に低減することができた。

【0030】これまで説明してきた実施例においては、基板上の1つのLSIとその1辺方向に複数のバイパスコンデンサが実装されている簡略化された給電構造にてその効果を示したが、基板上に複数のLSIが実装され、各LSIに対し4辺方向にバイパスコンデンサが搭載された給電構造に対しても同様の効果を得ることが出来る。また、LSIの有する電源パンプ間隔も1mm以外であっても同様の効果が得られることは言うまでもない。

【0031】また、これまで説明してきたインダクタンスの関係が満足されるのであれば、ハンダボールでなくとも、ポリマーパンプなどの樹脂を用いた接続構造、C

uなどの金属を用いて形成されたパンプであっても良い。

【0032】また、BGAタイプの半導体装置について説明してきたが、これに限らず、CSP、WFPなどの半導体装置はもちろんのこと、QFPなどのリードタイプの半導体装置であっても同様の効果を得ることが出来る。また、ベアチップの実装についても同様である。この場合、ベアチップの有する金パンプがACFや導電性接着剤やはんだ材料を介して接続されるのが一般的であるが、ここで接続部位はACFや導電性接着剤やはんだ材料と金パンプとを含むものとなる。

【0033】また、ハンダパンプを構成するはんだ材料としては低インピーダンス接続の観点からして非磁性体かつ低抵抗なものが良い。

【0034】以上述べたように、絶縁層の膜厚を30 μm 以下に薄く構成された電源層は、電源配線層及びGND配線層を流れる電流間の相互電磁誘導によって高周波領域で問題となるインダクタンスを低下でき、より低いインピーダンスで隣接するLSI内部容量間、及びLSIとバイパスコンデンサを接続することが出来る。これにより電源経路に構成された各バイパスコンデンサからの電荷供給を容易にし、給電構造の電源-GND間インピーダンス低下させ低コストな低雑音給電系を実現できる。

【0035】

【発明の効果】本発明によれば、給電系の電源インピーダンスを低減した実装基板を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】LSI等を実装した基板構成を示す図

【図2】バイパスコンデンサの配置を示す図

【図3】LSIのパンプ構造を示す図

【図4】図1に示す実装構造の2次元等価回路モデルを示す図

【図5】従来の実装構造を示す図

【図6】LSIとバイパスコンデンサを接続する電源層の電源パンプ間インダクタンス解析結果を示す図

【図7】インピーダンス周波数特性を示す図

【図8】LSI等を実装した基板構成を示す図

【符号の説明】

101 LSI
102 バイパスコンデンサ
103 基板
104 電源層
105 電源配線層
106 絶縁層
107 GND配線層
108 ハンダボール
109 スルーホール
301 電源パンプ
302 GNDパンプ

(5)

特開2001-308222

7

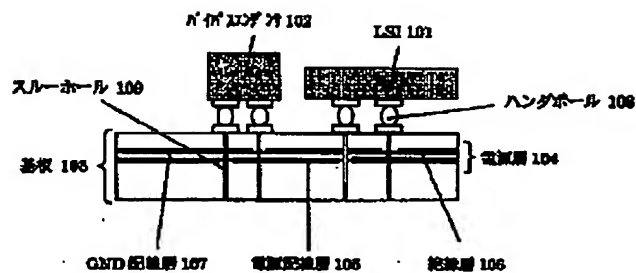
8

401 電源幹線
402 LSI等価回路
403 LSI内部容量

* 501 MCC
502 コンデンサ層
* 801 薄膜電極層

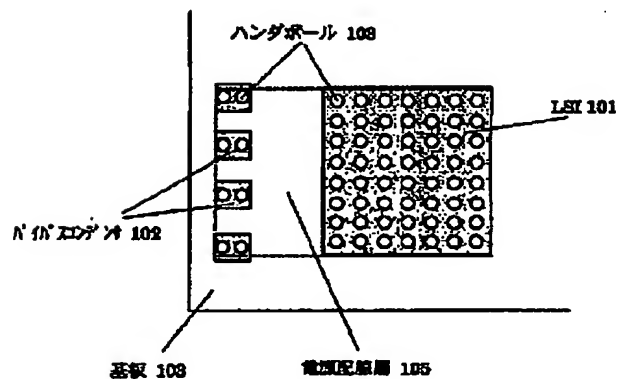
【図1】

図1



【図2】

図2

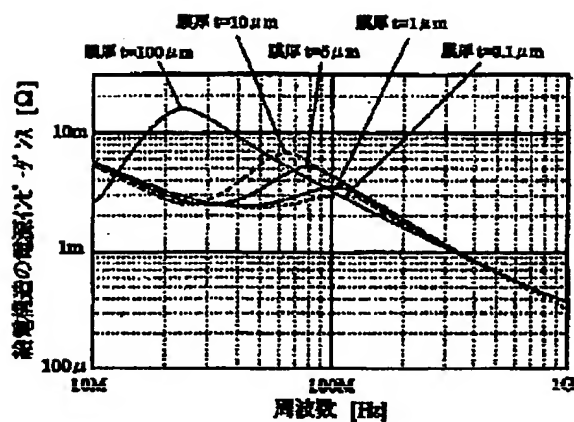


(8)

特開2001-308222

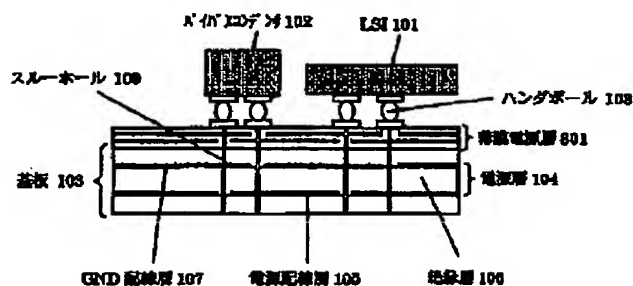
【図7】

図7



【図8】

図8



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

H05K 3/34
// H01L 25/065
25/07
25/18

識別記号

505

FI

H01L 23/12
25/08

キーワード (参考)

E
B

(72)発明者 林 良彦

神奈川県横浜市戸塚区吉田町252番地 株
式会社日立製作所生産技術研究所内

(9)

特開2001-308222

Fターム(参考) SE319 AA03 AB05 AC01 BB04 CC33
GG01
SE336 AA04 BB03 CC32 CC53 CC58
EE01 GG11
SE338 AA03 AA16 BB63 CC01 CC04
CC06 CD11 EE13 EE14
SF044 KK07 RR01